

DLEC-675

- 适用
- PCB硬板、FPC软板、软硬结合板
 - HDI

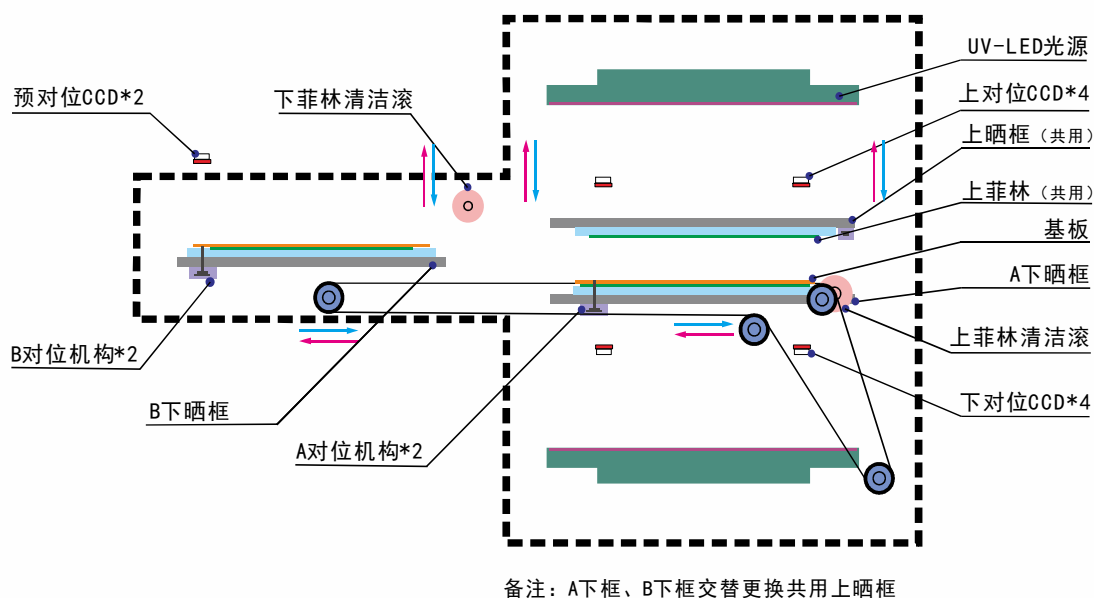
产品特点

- 高产能(阻焊)：双面同时曝光，
(黑油、白油：4-5片/分钟；常规油：5-7片/分钟)；
- 高解析度：最小线宽线距65um/65um；
- 高对位精度：动态CCD精准对位, $3\sigma < 15\mu\text{m}$ ；
- 自动清洁菲林：内置自动粘尘装置；
- 自动上下料：协作机器人多方位自动上下料；
- 对位快、准：双框交替自动对位；
- 体积小：(3500×1600×2100)mm³。

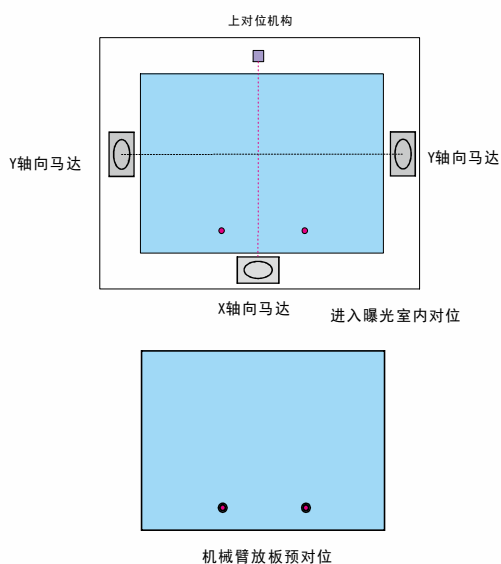
重磅
首推



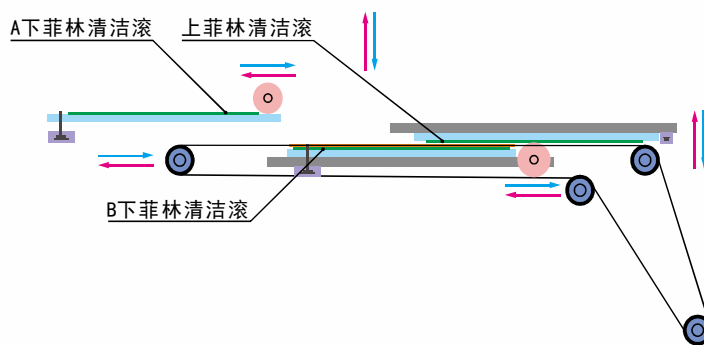
曝光机构造示意图



基板在曝光室内对位



上菲林 下菲林清洁示意图



DLEC系列产品参数

型号		DLEC-350	DLEC-375	DLEC-675
生产规格	平板工件尺寸	150*250 ~ 250*450mm	350*355~620*730mm	305*355~620*730mm
	平板工件厚度	0.01~3.2mm	0.5~5mm	0.5~3.2mm
	底片尺寸	300*500mm (12"*20")	660*760mm(26"*30")	660*760mm(26"*30")
生产能力		内层线路6-7片/分钟	外层线路5~ 6片/分钟	阻焊4~ 5片/分钟
光源系统	光源类型	反射式UV-LED	扫描式UV-LED	位移式UV-LED
	能量均匀度	>90%	>90%	>85%
	板面照度	100mw/cm ²	200mw/cm ²	400mw/cm ²
	平行半角	<2°	<3°	<5°
	线路解析度	35μm/35μm	50μm/50μm	65μm/65μm
控制系统		PC+PLC+网络远程控制		
传送系统	输送高度	950±50mm		
	移栽、定位	机械手视觉+伺服传送		
对位系统	对位精度	3σ<8μm	3σ<10μm	3σ<15μm
	对位方式	4CCD对位	8CCD双面分别对位	8CCD双面分别对位
工作台面	接触式曝光	玻璃对玻璃，双面同时曝光		
	清洁方式	上、下菲林自动粘尘		
冷却方式	曝光室	强制气冷		
	灯源	循环水冷		
机器外型	机械尺寸	3500*1600*2100 mm		
	机械重量	2100kg	2300kg	2500kg
环境要求	空气洁净处理	Class10000		
	温度	20℃±3℃		
	湿度	55%±10%		
外部设施	电力供给	AC 380V 30A	AC 380V 50A	AC 380V 100A
	气压源	0.6Mpa,0.1-5m ³ /min		
	冷冻水供应	20L/min 7-12℃	50L/min 7-12℃	80L/min 7-12℃